

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 平野博茂 副委員長 大見俊一郎

幹事 森 貴洋・小林伸彰 幹事補佐 野田泰史・諏訪智之

日時 2月5日(金) 13:00~17:25

会場 オンライン開催

議題 配線・実装技術と関連材料技術

1. [招待講演] Process Integration of Ru Area Selective Metal Capping for sub 30 nm Pitch Cu Damascene Interconnect Hirokazu Aizawa (TTCA)
2. 熱力学シミュレーションを用いた Co 合金単層バリア材料の探索
○山田裕貴・矢作政隆・小池淳一 (東北大)
3. TaN 薄膜のバリア特性の限界
○久家俊洋・矢作政隆・小池淳一 (東北大)
4. [招待講演] 1 μ m ピッチ Cu-Cu 接続に対する接合ずれの影響
○香川恵永・上林拓海・羽根田雅紀・藤井宣年・古瀬駿介・橋口日出登・平野智之・岩元勇人 (ソニーセミコンダクタソリューションズ)
5. [招待講演] 材料開発のための AI と, AI のための材料開発
山道新太郎 (日本 IBM)
6. [招待講演] 3次元集積実装技術の現状と今後の展開
菊地克弥 (産総研)
7. [招待講演] 3D 冗長と Wafer-on-Wafer (WOW) テクノロジーを用いた Bumpless-Build-Cube (BBCube)
○菅谷慎二・中條徳男・作井康司・良尊弘幸・中村友二・大場隆之 (東工大)

◆応用物理学会共催

【問合先】

森 貴洋 (産総研)

TEL [029] 849-1149

E-mail: mori-takahiro@aist.go.jp